

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信 额度内融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的情况

为满足公司经营发展的资金需要，2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2026 年度授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。根据公司《融资管理制度》，年度综合授信额度内的银行借款融资行为由公司董事长全权办理。

同意公司及下属全资子公司为自身或互为对方申请综合授信、实际借款提供担保，担保额度合计不超过上述综合授信额度，不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。前述额度范围内的担保事宜，由公司总经理办公会进行具体审批。

二、会议审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、公司影响

公司本次申请金融机构综合授信及为综合授信额度内融资提供担保是公司实现业务发展和正常经营所需。通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2026年1月27日